

锦州神工半导体股份有限公司 关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次申请的金融机构综合授信额度为：8 亿元
- 使用期限为：自董事会审议通过之日起 12 个月内

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司根据业务发展需要，拟在董事会作出决议之日起 12 个月内向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，授信类型包括但不限于：远期结售汇、贷款、贸易融资、融资租赁、票据承兑、进出口押汇、进出口代付、开出信用证等业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行金融机构协商确定。该授信额度在授信期限内可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《中华人民共和国公司法》相关规定及《锦州神工半导体股份有限公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司、股东的利益。

为提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，董事会同意授权公司管理层指定的授权代理人在上述额度和期限范围内全权办理向银行申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件，具体事项由公司

财务部门负责组织实施。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日